

# 苏州纳芯微电子股份有限公司

## 投资者关系活动会议纪要

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会
参与单位名称	嘉实基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、兴全基金、正心谷投资、敦和资产、大朴资产、奇盛基金、东吴证券自营、天风证券自营、永禧资产、中信证券、中泰证券、美银证券、兴业证券、华泰保兴基金、Aspoon Capital Limited、Monolith Management Limited、Spathiphy Capital Management Limited、Taikang Asset Management (Hong Kong)、Burgundy Asset Management Ltd、Regal Funds Management Asia Pte. Limited、Toroa Management (HK) Limited、Pinpoint Asset Management Limited、Temasek、Credit Mutuel、Q Fund、Boyu Capital、SRS Investment Management 等
时间	2024年11月5日-11月11日
公司接待人员姓名	投资者关系总监 卢志奇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q：公司第三季度汽车电子领域的营收情况？</b></p> <p>A：2024年第三季度汽车电子领域营收达1.96亿元，环比增长26.33%，单季度营收占比达38%。今年前三季度，公司供电电源LDO、高低边开关、马达驱动等电源管理新品实现量产。</p> <p><b>Q：公司在汽车应用的单车价值量多少？以及长期可达到价值量多少？</b></p> <p>A：目前公司可提供的量产产品价值量大概在600元人民币左右，到年底大概能提供单车价值量大概800元人民币以上；目前如果所有已规划或者在研的产品并且能够顺利量产的话，大概可能还需要个三年左右的</p>

时间，我们应该有机会能够把单车价值量拉到大概 3000 元人民币。

**Q：公司各个下游市场行业需求景气度的情况？**

**A：**目前工业市场的库存水位已恢复到正常水平，但市场需求仍疲软。光伏市场正在去库存，预计可能到今年年底至明年一季度能回到正常库存水平，当前需求低于正常需求。通信行业库存去化也需到年底至明年一季度完成。而汽车电子市场，尤其是中国市场需求旺盛，在新能源车带动下，呈现新物料增长机会，整体需求较为旺盛。

**Q：公司在海外客户布局的进展情况？**

**A：**公司在德国、日本、韩国等国家设有分支机构，同时配备了相应的本地化服务的销售团队等。公司在海外布局的应用市场主要是汽车和工业，公司已经通过多家海外 tier1 客户的供应商认证，并且部分客户已经开始稳定供货。同时，公司也非常注重和海外龙头 tier1 汽车厂商深度合作，近期公司和大陆集团宣布达成战略合作，双方将共同开发具有功能安全特性的汽车级压力传感器芯片，全新开发的压力传感器芯片将基于大陆集团的下一代全球平台，在可靠性和精度等方面进行重点提升，可用于实现更加安全、可靠的汽车安全气囊、汽车侧面碰撞监测和电池包碰撞监测系统。

**Q：并购方面的重点方向可能包括哪些产品或领域？**

**A：**公司未来投资并购的重点将继续围绕主营的汽车电子和泛能源赛道，通过并购补全核心能力和产品组合，尤其是关注高速类和处理器类

产品等与公司现有产品有良好系统协同效应的方向。

**Q：在汽车领域的新产品量产情况？以及展望明后年新产品和布局方向？**

**A：**我们在汽车领域持续布局，其中在汽车三电领域，尤其是电动车动力电机电控部分的驱动芯片，市场份额增长显著。此外，我们已实现大规模出货的产品包括多通道尾灯驱动芯片、磁电流传感器芯片以及部分接口芯片。今年，马达驱动类芯片和集成式电机驱动 SOC 芯片也开始在市场上取得头部客户的多个项目定点，预计明年将进入规模量产阶段并实现快速增长。另外，高边开关类产品也已完成产品的发布，并将在明年陆续有量产。明年我们将在座舱领域重点布局，预计会实现视频传输 Serdes 芯片、电源管理芯片、音频功放芯片（如 Class D 功放芯片）以及车载音频总线 A2B 产品的量产发布。此外，在 MCU 产品方向，针对能源和汽车电源领域的 MCU 主控类产品，预计将在年底至明年初正式推向市场。同时，我们还在研发集成电源管理类产品和底盘安全类产品，例如轮速传感器、碰撞压力传感器以及功能安全相关的马达驱动等，这些产品在未来也将陆续进入送样和量产阶段。

附件清单（如有）

无

日期

2024年11月11日